

国家集成电路设计西安产业化基地参加

## 2019世界半导体大会暨第十七届中国半导体市场年会



5月18日，“2019世界半导体大会”在南京国际博览中心隆重召开，国家集成电路设计西安产业化基地参加此次盛会。

本次大会邀请姚建院士、马佐平院士、王元元院士、蔡跃院士、黄如院士、蒋高义院士、魏少军教授、严晓浪教授、时发兴教授等嘉宾出席大会开幕式。众多国内外政要、行业专家、企业家，以及业内精英出席，共同探讨全球与中国半导体产业最新发展趋势与广阔合作前景。

开幕式上，南京市人民政府市长蓝绍敏及工业和信息化部总经济师王新哲等领导莅临大会并致辞。

清华大学微电子研究所所长、中国半导体行业协会副理事长魏少军表示，技术不是万能的，但没有自己的核心技术是万万不能的。创新发展要敢为人先，敢于打破常规，要容忍不致，绝不轻言放弃，要敢于尝试，不拘泥与现实，要不怕失败，摔倒再站起来。要用最好的技术，最好的人，做最好的产品，要精益求精，把事情做到极致，调动和利用一切可以利用的资源，要敢于否定自己的现在，才能创造自己的未来。

SEM全球副总裁、中国区总裁周龙预计2019年全球半导体产值将停滞甚至轻微衰退。并从中国视角和美国视角详细回顾了中美贸易事件，表示SEM是，主张自由贸易、开放的市场、共赢与合作以及保护知识产权，反对贸易摩擦的国际的，中立的组织。并呼吁美国政府不要实施加征关税、限制投资、实施出口管制等措施。

下午，在由中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社联合主办的“第十三届（2018年度）中国半导体创新产品和技术评选”中，西安微电子研究所的功率驱动系列电路和西安中车永电电气有限公司的高压大功率IGBT模块封装设计制造平台研发及产业化两个项目分别获奖。

## 西安产业化基地与华大九天 签订合作协议，推动芯片国产化进程

为提高西安集成电路产业的健康快速发展，加速推动我国自主可控芯片研发进程以及培养集成电路设计人才，国家集成电路设计西安产业化基地与北京华大九天软件有限公司签订合作协议，建立合作关系。

双方基于华大九天的核心业务集成电路设计自动化（EDA）软件、链知识产权（IP）和相关技术支持，结合西安产业化基地的行业资源和影响力，共同推动西安集成电路产业的整体实力，加强产业链协调发展，共同推动芯片国产化替代进程，培育创新型集成电路企业。

未来，西安产业化基地与华大九天在提高企业核心竞争力的同时，还将举办更具规模和影响力的科技创新活动，为本地集成电路业务注入新的创新动力。

## IC设计与优化技术研讨会圆满召开



5月27日下午，“IC设计与优化技术研讨会”在国家集成电路设计西安产业化基地（西安ICC）召开。此次研讨会由西安ICC与北京华大九天联合举办，吸引了10家集成电路设计企业，3家研究所和2所高校共23位技术人员参加。

西安ICC赵群总经理首先对我国半导体产业现状及产业化基地的情况进行了介绍。随后，华大九天产品经理时铭明向与会人员介绍了华大九天的总体业务，并与产品经理陈志分别对“高效的模拟/数模混合全流程设计方案”和“Yield-PPA driven SoC特色解决方案”进行了详细的讲解。会后，与会人员与两位产品经理进行了深入的技术交流。

此次研讨会的成功举办，加强了西安本地集成电路设计人员和国产EDA厂商的深入交流，持续推动集成电路产品的国产化替代进程。

会后行业内相关人士也进行了良好的互动。此次会议有序圆满完成。

## 西安产业化基地与安创生态签订合作协议

为更好地推动西安市集成电路产业整体实力提升,赋能于西安及周边地区传统产业转型升级,2019年6月3日,国家集成电路设计西安产业化基地与安创生态科技(深圳)有限公司签订合作协议,建立合作关系。

双方以提高专业化支撑服务为目的,以加强产业链协调发展为动力,共同推进西安市整机厂商、系统集成商、半导体企业自主知识产权芯片的研发、应用和技术创新,推动西安市电子信息产业国产化率的提升和传统产业的转型升级。

## “成功企业家进校园宣讲”报告会在西安邮电大学成功举办



5月29日,国家集成电路设计西安产业化基地邀请西安西谷微电子有限公司总工程师朱元清,在西安邮电大学电子工程学院开展了一期别开生面的“成功企业家进校园宣讲”报告会,此次报告会以集成电路产业情况介绍及人才需求为主题,除阶梯教室座无虚席,吸引了超过110名师生前来聆听。

首先,朱元清对西谷微电子公司概况及经营理念进行介绍,随后并围绕集成电路分类(IC设计、制造、封装)、国内集成电路现状以及未来集成电路行业发展趋势进行了报告,朱元清还针对西安邮电大学师生提出的现阶段行业动态及未来行业走向等一系列问题进行了分析解答。

此次校园宣讲报告会的成功举办,在西安邮电大学反响热烈,使同学们对目前的学习态度和奋斗目标更加明确,对为未来择业就业及长期发展提供了非常有价值的参考。

国家集成电路设计西安产业化基地作为高校、企业与政府之间的桥梁纽带,利用扎实的产业服务和技术服务基础,联合高校全面提高本地集成电路专业人才培养能力,优化本地专业人才培养,激发人才活力提供了更加强有力的支持,为本地集成电路产业快速发展提供了良好的协同创新环境。

## 第四届丝绸之路国际博览会开幕 举办6大板块30多场活动



5月11日,以“新时代·新格局·新发展”为主线的第四届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会在西安正式开幕。

本届博览会由国家发展改革委、商务部、中国侨联、全国工商联、中国贸促会、国家市场监督管理总局和陕西省人民政府共同主办,由俄罗斯联邦、柬埔寨王国担任主宾国,由吉林省、重庆市担任主宾省(市),由汉中市担任主题市。

本届博览会将举办主题论坛、重要会议、投资贸易促进活动、主场国际活动等6大板块共30多场活动及相关展览展示,着力为“一带一路”共建国家和地区创造交流互鉴的机遇,构筑务实合作的平台。同时,充分发挥“一带一路”建设对西部大开发的带动作用,推动我国西部地区在更大范围、更高层次上的开放。

在5月11日至15日的会期里,将举办丝绸之路经济带国际合作论坛、欧亚国际合作论坛、2019丝绸之路商务合作(西安)圆桌会、丝绸之路国际商会(西安)圆桌会、中国(陕西)自由贸易试验区发展论坛等涉及经济、文化、旅游、法律、投资便利化自由化等领域的30多场国际会议和论坛活动。西安曲江国际会展中心设置1个合作交流馆,体现主宾国、主宾省(市)整体形象、资源优势、特色产业和重大合作项目;4个产业馆集中展示航空电子技术、卫星导航北斗应用、智能制造、高档数控机床、环保技术与产品、第五代移动通信技术、生物科技等领域的最新产品与技术。在西安绿地笔克国际会展中心设置1个特色商品馆,总展览面积8万平方米,与此同时,在海上湾设立“丝博会上海之窗”,展览面积1000平方米,主要

展示推介陕西省各市区名优产品和非遗文化产品。

本次展览全面展现西安市紧扣“一带一路”倡议,培育新动能、构筑新高地、激发新活力、共创新生活、彰显新形象的生动实践。“以电子信息为主的万亿级高新信息产业”展区主要展示人工智能、信息技术、生物技术、光电子芯片、新经济等领域成果;“以新能源汽车和航空制造力为主的先进制造业”展区主要展示新能源车、新材料、航空航天、智能制造、军民融合等领域的成果;“以实体经济、门牌经济、流动经济为主的万亿级现代服务业”展区主要展示商贸、物流、金融、总部经济等领域的成果。“万亿级文化旅游产业”展区主要展示文化、旅游等领域的成果。

同时,西安市的展区根据市场需求,按产品类别和产业类别进行跨区域布局,普遍应用声、光、电等多媒体技术手段,充分融入现代感、科技感,进一步凸显西安国际化大都市形象。展示展品涉及新能源车、航空航天、高新技术、人工智能、新材料、文化旅游、生物医药等多个领域。

丝博会是中国唯一以“丝绸之路”命名的国际博览会。自2016年3月,经党中央、国务院批准,将中国东西部合作与投资贸易洽谈会(此前简称“西洽会”)升格为丝博会以来,充分发挥陕西丝绸之路起点、内陆改革开放新高地、中国(陕西)自贸试验区新优势,围绕“一带一路”倡议,积极落实“一带一路”国际合作高峰论坛成果,在创新发展、合作共赢、科学配置资源、不断改进服务,至今已经成功举办了三届。

来源:中国日报网

## 2019西安国际创业大会暨全球INS大会召开

“智”感来袭 助力西安“双创”升级



6月11日下午，以“文化链接科技，赋能创新西安”为主题的2019西安国际创业大会暨全球INS大会在西安曲江国际会议中心隆重举行。大会经科学技术部火炬高技术产业开发中心、陕西省科学技术厅指导，由西安市政府主办，市科技术局、市发改委及曲江新区管委会等单位承办。

本次大会设有2019西安国际创业大会、“一带一路”科技园区合作座谈会、2019西安·全球INS大会、2019西安国际创业大会嘉年华4个主要活动。汇集了众多国内外知名专家学者、创投大咖、国际创业先锋、新经济领域领军人物、本土创业新势力等重量级嘉宾，为西安拓展国际视野、创想科技未来、打造西安“双创”升级版加注新引擎和创新动力。

### 行业领袖齐聚西安 激发无限创造力

2019西安国际创业大会暨全球INS大会致力推动全球化发展、科技文化创新、跨行业互联及多方合作。今年大会更聚焦人工智能、智能通讯、数字创意智造、短视频、网红经济、零米生活圈、城市更新、文旅融合、文化短跨升级前沿领域，为西安创业者提供与行业领袖面对面交流的学习平台。

众多专家学者、创投大咖的真知灼见使现场充满“智”感。在单国经济由高速增长阶段向高质量发展阶段的过程中，如何面对机遇与挑战并存的新经济命题，是“双创”从业者普遍关心的议题。北京大学中美人文交流研究基地执行副主任、盘古智库学术委员会秘书长王砾以“西全球化 理解中国与世界互动的新时代”为题，阐述当今国际局势大背景下，创业者所要面对的时代洪流与历史使命。

谈及未来三年的商业世界新机遇，真格基金董事总经理兼华东区负责人顾昱昱、梅花天使创投合伙人张毅、西安曲江文化金融控股有限公司总经理李阳、陕西天资本管理有限公司董事长赵承平从金融投资、创投等角度展开



了深度的讨论。在5G牌照提前发放拉近人们对物联网世界的想象的同时，智能通讯技术的产业状况和未来发展前景引人关注。Akkuadi 联合创始人兼CEO Alvaro Montoya结合当今实际详细解读“智能通讯”，并就其广阔的市场前景及应用场景进行分析。

### 创客嘉年华互动Party 营造十足未来感

大会当天，结合西安“两都两城”的整体定位而打造的2019西安国际创业大会嘉年华，为参观体验者展示出十足未来感。

此次嘉年华分设“数字”、“文创”、“科技”、“国际”、“INS”等5个主题互动岛，实现“文化”与“科技”的完美融合。同时，以西安创新创业成果为主要内容，打造西安创客能量场，展现包含硬科技创新成果、双创成果展等，同时植入西安市创新创业政策、各类型双创载体展示。

### 助力西安“智”造 赋能“双创”升级

在全国“双创”浪潮下，自国务院《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》印发以来，西安市、市政府以打造“创业西安”城市品牌，建设“一带一路”创新创业之都为重点，将双创工作提升到“激发创新活力，推动经济发展”的新高度。依托雄厚的科技实力、人才资源与政策优势，持续深耕前沿技术，凝聚先锋力量，完善创业生态，打开全球视野，正逐渐成为世界瞩目的创新创业乐土。作为2019西安双创周的重要活动之一，2019西安国际创业大会暨全球INS大会的召开，将拉开西安双创周活动的序幕。在双创周活动期间，西安市将举办“2·8+N”系列活动，为古城西安带来一场更具国际视野和产业前沿的创业盛典，助力西安大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进。

来源：三秦都市报 · 三秦网

## 江丰电子签订合作框架协议 拟在西安高新区设立技术研发及生产基地

5月13日，江丰电子发布关于签订合作框架协议的公告。

公告显示，江丰电子与西安高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“西安高新区”）、西北欧美绿建置业发展有限公司（以下简称“西北欧美”）于2019年5月12日在西安签订了《合作框架协议》（以下简称“框架协议”），约定公司未来几年在西安高新区设立技术研发及生产基地。

据披露，1991年3月西安高新区被国务院首批批准为国家级高新区。西安高新区通过体制创新和技术创新，在园区建设、环境营造、成果转化、招商引资、产业发展方面成果显著。

西北欧美成立于2018年11月27日，为北京绿城投资有限公司全资子公司，经营范围包括房地产开发及销售；建筑工程施工、设计；物业管理；园林景观设计；企业管理咨询。

投资意向书的主要内容：1、公司未来几年拟在西安高新区设立技术研发及生产基地。2、西安高新区承诺为项目实施提供便利条件及协调服务。3、如各方在合作过程中出现问题，各方同意通过协商友好解决。

江丰电子表示，本次合作的具体安排尚待各方进一步商议确定。有关合作事项均以各方签署的正式投资协议或具有约束力的其他法律文件为准。截止本公告披露之日，各方尚未开展具体的合作事宜。且本次合作属于意向性的约定，因此，本次合作对公司2019年的营业收入、净利润不会构成重要影响，对公司长期收益的影响尚无法预测。

如本次合作签订并履行正式协议，在西安高新区设立技术研发及生产基地，将对公司未来发展具有积极意义，有利于公司为西北地区的电子信息产业客户提供更便捷优质的服务，进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。

来源：爱集微

## 比特大陆研究院及算力中心落户西安高新区

近日，西安高新区在高新国际会议中心举行“首届高新”推介会暨第四届丝路博览会西安高新区专场签约仪式。现场签约41个项目，签约总金额1409亿元。

本次签约项目涵盖电子信息、先进制造、生物医药、总部经济、城市配套、金融服务等六大领域。

电子信息方面，北京比特大陆科技有限公司将其研究院及比特大陆算力中心落户高新区。

此外，西安高新区将与华为公司在5G产业发展、智慧城市、智慧校园、智慧医疗领域深化战略合作，将高新区打造成全国智能科技产业和智慧应用创新的标杆。

中国电信计划在高新区投资30亿元，用于高新区5G基站及5G网络基础设施建设，重点选取自动驾驶、远程医疗、远程教育、工业互联网、智慧交通领域，打造5G示范网络。

来源：爱集微

## 西安2019年重点在建项目计划：三星闪存芯片二期年底前量产

日前，《西安市2019年重点在建项目计划》发布，电子信息产业类项目在其中占有重要一环。在建项目中，电子信息类技术项目有16个，总投资749.5亿元，2019年计划投资212.2亿元。前期筹备中，电子信息类技术7个，总投资353.9亿元。以下为项目具体情况。

**在建项目：**2019年度重点项目中，包含三星、华为、华天科技等国内外知名企业重点项目，其中三星闪存芯片二期项目预计在年底设备搬入并开始量产。

**三星（中国）半导体有限公司12英寸闪存芯片二期项目：**2017年8月30日，三星电子株式会社与陕西省政府签署了投资合作协议，决定在西安高新综合保税区建设三星（中国）半导体有限公司存储芯片二期项目。

该项目总投资450亿元，2019年计划投资170亿元，项目建成后，可以生产V4NAND闪存芯片6.5万片/月，预计2019年底项目竣工，设备搬入并开始量产。

**华为西安（二期）项目：**华为西安研发基地二期项目是华为全球技术支持中心新基地，是华为除总部最大的研发基地。该项目总投资14.3亿元，预计年底进行基地开挖。

**FCLGA集成电路封装测试和先进生物识别模组产业化项目：**该项目由华天科技投资建设，将引进国际先进的集成电路封装测试设备1868台（套），配套国产设备1380台（套），年新增 FCLGA等系列产品封装测试能力46亿只；先进生物识别传感器（虹膜识别）产业化项目引进国际先进的集成电路封装测试设备1560台（套），配套国产设备1070台（套），年新增 先进生物识别传感器等系列产品封装测试能力40亿只。该项目预计年底进行厂房基础施工。

**前期筹备项目：**前期筹备项目中，包括中国（西安）芯片产业园、浪潮西安产业园项目、运通谷物联网研究院及全球应用中心项目、亚马逊AWS项目、中电科大微电子产业园有限公司西安产业园项目、虹光电子集团真空电子技术产业化项目、西安人工智能与机器人产业园项目（大管二期）等七大项目。

其中，中国（西安）芯片产业园总投资200亿元，将打造一个生态的、全产业链的微电子家园，计划落地西安电子科技大学校园的西南侧。

西安人工智能与机器人产业园项目（大管二期）计划总投资1.5亿元，将建设西安人工智能与机器人产业园，作为机器人产业集群载体。预计到2020年底，实现年产值5亿元；到2022年，实现年产值10亿元以上。

来源：安集唯

## 总投资2139.66亿元

## 华为人工智能产业创新基地等65个项目落地西安

5月12日，西安市投资环境推介暨重点项目签约仪式上，共签约65个项目，其中，合同项目51个，总投资额2139.66亿元，包括华为人工智能产业创新基地项目、百度云计算（西安）中心项目、海创园半导体材料项目、5G智慧应用项目等。

其中，华为技术有限公司和航天基地签订了华为人工智能产业创新基地项目，主要建设内容包括人工智能创新中心(含人工智能开发平台、人工智能孵化平台人工智能展示中心)、人工智能人才培养、人工智能生态构建、航天基地样板工程、人工智能产业园区、人工智能城市新名片等六个板块。

百度公司和航天基地签订了百度云计算（西安）中心项目。据介绍，百度云计算（西安）中心项目将建设成为绿色节能、技术领先的超大规模云计算中心。项目园区占地面积约127亩，规划建设机房楼、综合办公楼及附属用房等，建筑面积约90000平方米，服务器机柜容量超过10万台。这将是百度在西部布局的首个单体规模超过10万台的超大规模自建数据中心，数据中心的产业链涉及电子元件、硬件设备、基础软件、平台与应用软件等各类研发与制造企业，以及电缆、机电设备等相关企业。

海创园半导体材料项目是由宁波江中电子材料股份有限公司与绿城中国计划在西安高新区投资建设“海创园半导体材料项目”项目，预计投资2亿元，建设超高性能金属靶材研发和生产基地。

5G智慧应用项目是由西安高新区、中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司、中兴通讯股份有限公司签订《5G融合合作框架协议》，到2022年，建设5G基站30座，累积投资40亿元。

此外，本次签约还包括腾讯智慧媒体总部、西安高新-腾讯云丝路总部基地及东环总部、西安航天基地达科创新、西咸丝路汽车智慧谷、特化智联西北运营中心、西安南站铁路智慧物流信息基地等众多项目。

来源：安集唯



## 西安发改委：三星半导体配套2期秀博瑞股新建项目主体已完工



据西安市发改委消息，4月底，西安772个市级重点在建项目共完成投资1491.26亿元，占年计划的37.28%

按行业来看，108个先进制造业领域提升工程完成投资211.33亿元，占年计划的36.83%。新型电力电子化及其他集成电路项目部分主体封顶。三星半导体配套2期秀博瑞股（西安）电子材料有限公司新建项目主体已完工。大型金属膜压制产品研发与生产项目已完成核心设备安装调试，并已实现生产交付。

三星半导体配套2期秀博瑞股（西安）电子材料有限公司新建项目总投资2.4亿元，总建筑面积约1.2万平方米。项目拟建的主要建筑物为生产厂房，进行新建4条生产线，包括印刷蚀速生产线、LAL500生产线、HGN生产线、PAN ETCHING生产线。项目达成后将实现年产能约68400吨/年，并拟建辅助用仓库及综合楼等建筑物。

来源：西安发改委

## 首批5G试点城市最新名单公布！西安入选！

工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G牌照，这意味着四家运营商将可以正式建设5G网络。

中国电信、中国移动、中国联通今年将分别在至少40个城市覆盖网络，并在部分城市推出5G服务，其中包含西安。

中国移动：9月底前推5G服务。中国移动表示，获得5G业务经营许可后，中国移动将加快5G网络部署，打造全球规模最大的5G精品网络。中国联通：已在40城推出5G演示体验厅。中国联通称，牌照发放后，将视网络建设和终端供货情况继续扩大友好体验用户的范围和数量。目前，已在40个城市推出了5G演示体验厅。

来源 西安晚报

## 海创园半导体材料项目开工 西高新揭开半导体产业新篇章



6月2日，西安高新区海创园半导体材料项目在长安通讯产业园正式开工。西安市委常委、高新区党工委副书记、航天基地党工委副书记钟洪江与合作方代表出席活动并启动开工仪式。

西安高新区海创园由国际一流芯片关键材料制造企业——宁波江丰电子材料股份有限公司和理想生活综合服务商绿城中国强强联合，共同打造，将立足西安高新区，建设成为全球技术领先的超高性能金属靶材研发和生产基地。在做强高新区半导体产业链的同时，壮大国家品牌。

据介绍，该项目建成后将在超高性能金属及大型设备关键部件生产上实现突破，完善西安高新区乃至中国半导体产业链。将在中国西部地区材料产业与半导体及整个电子行业应用间搭建桥梁，推动有色金属技术与质量改进，进一步提升拉动我国西部材料产业的发展。项目将实现产业链模式创新、战略模式创新、价值化模式创新、需求化模式创新。

开工仪式上，西安高新区管委会副主任贾铁良表示，半导体产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性新兴产业、基础性产业。加快发展半导体产业是抢抓新一轮科技和产业革命机遇与战略需求。宁波江丰电子作为我国新材料领域的发展精英，凭借扎实的研发能力和刻苦的技术攻关，在超高性能金属靶材产业领域打破了国外垄断。本次江丰电子和绿城中国强强联合，在西安高新区建设海创园半导体材料项目，将揭开西安市及高新区半导体产业发展的新篇章。为西安乃至陕西的半导体产业发展注入强劲动力。

宁波江丰电子材料股份有限公司董事长姚力军说，芯片制造产业市场前景广阔，依托西安高新区完整的高科技产业链，海创园半导体材料项目在西安高新区落地建设生产。将立足高新与区域产业配套，面向全球走向国际化，力争满足国内芯片需求，并在国际市场中占据一席之地。

来源：三秦都市报 - 三秦网

## 激光雷达之外别有洞天，飞芯电子：ToF传感器6月份将出模组

据西安日报报道，西安飞芯电子科技有限公司（以下简称“飞芯电子”）研发部总监张冰透露，飞芯研发的ToF（飞行时间）传感器将在6月份出模组。真正显示出中国的ToF传感器。

ToF传感器是飞芯电子的核心产品之一。

公开资料显示，西安飞芯电子科技有限公司成立于2016年，是一家专注于光电设备、激光雷达研发、集成电路设计的民营高新技术企业。成立后，飞芯电子先后获得了Bosch(博世)、西科天使、上海峰瑞、金沙江联合等注资。2018年8月，飞芯电子完成了最新一轮数千万元融资，由Bosch和奥比中光共同领投。

西安飞芯电子自成立以来，通过自主研发的芯片设计、电路设计、信号处理、系统集成等核心技术，研制低成本、体积小、高可靠且具有高抗干扰性和对人体保护的激光雷达产品。

据西安日报报道，张冰介绍，有效解决激光雷达技术中的非视问题是飞芯攻坚的核心方向。飞芯电子掌握固态激光雷达从芯片结构设计、电路设计到系统集成全产业链的自主知识产权，从芯片源头提供激光雷达的解决方案。未来可广泛应用于汽车的辅助驾驶和自动驾驶中，以及无人机、工业控制、机器视觉等人工智能领域。

来源：壹集微

## 国务院常务会议：延续集成电路和软件企业所得税优惠政策

国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议，部署推进国家战略性新兴产业创新发展，打造改革开放新高地；决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业。

会议指出，目前我国共有219个国家经济技术开发区。生产总值、财政收入均占全国10%左右，进出口贸易、利用外资占20%左右。主要指标增速超过全国平均水平，同时还有很大新潜力有待释放。要贯彻落实中央、国务院部署，加快推进国家经济技术开发区开放创新、科技创新、制度创新，激发市场活力，发挥好其培育经济增长新动力、促进高质量发展

发展的优势。

一要支持经开区优化营商环境，推动在“放管服”改革方面走在前列。

二要推动创新发展。深化投资项目管理，推行容缺审批、告知承诺制等，将招商成果纳入经开区考核激励。对创新创业人员在户籍、子女入学、创业投资等方面给予便利。各地要主动作为，赋予经开区更大改革自主权，放出活力，管出公平。

三要推动创新发展。

经开区要率先将国家科技创新政策落实到位，成效明显的可加大政策先行先试力度。支持建设国家大科学试验装置和国家科技创新基地。区内科研院所转化职务发明成果收益给予参与研发的科技人员现金奖励，符合规定的可减按50%计入工资、薪金所得缴纳个人所得税。对经开区与职业院校共建人才培养基地等加大支持。

三要提升开放水平。

支持经开区引入民间资本和外资开发运营特色产业园等，鼓励港澳地区及外国机构、企业、资本参与国际合作园区运营。支持设立国际合作区。支持在有条件的经开区开展资本项目收支便利化等试点。

## 李克强主持召开国务院常务会议

● 决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策  
吸引国内外投资更多参与和促进信息产业

促进经济结构升级。会议决定，在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件实行所得税“两免三减半”或“五免五减半”基础上，对集成电路设计和软件企业继续实施2011年国务院有关文件

四要促进产业升级。

国家重大产业项目优先在区内布局。实施先进制造业集群培育行动、现代服务业优化升级行动。推动“双创”上水平。鼓励各类资本投资发展数字经济。

会议指出，集成电路和软件产业是支撑经济社会发展的战略性新兴产业、基础性产业。通过对在华设立的所有制企业包括外资企业一视同仁，实施普惠性减税降费，吸引各类投资共同参与和促进集成电路和软件产业发展。有利于推进经济结构优化升级，更好提高高质量发展和高品质生活需求。会议决定，在已对集成电路生产企业或项目按规定的不同条件分别实行企业所得税“两免三减半”（即第一年至第二年免征，第三年至第五年减半征收）或“五免五减半”（即第一年至第三年免征，第六年至第十年减半征收）的基础上，对集成电路设计和软件企业继续实施2011年《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策的通知》中明确的所得税“两免三减半”优惠政策。2018年度所得税汇算清缴也按上述规定执行。同时，有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

来源：澎湃新闻

## 工信部正式发放5G商用牌照 核心领域产业升级迫在眉睫

工业和信息化部2019年6月6日发布关于修订《电信业务分类目录（2015年版）》的公告，对《电信业务分类目录（2015年版）》（以下简称《目录》）进行了修订。增设“A12-4 第五代数字蜂窝移动通信业务”业务子类。具体业务表述为：“第五代数字蜂窝移动通信业务是指利用第五代数字蜂窝移动通信网络提供的语音、数据、多媒体通信等业务”。

工信部向中国联通、中国电信、中国移动及中国广电发放了5G商用牌照。中国是继韩国、美国、瑞士、英国之后，全球第五个开通5G服务的国家。

工业和信息化部副部长陈肇雄近期曾表示，我国5G技术和产品日趋成熟，系统、芯片、终端等产业链关键环节已基本达到商用水平，具备了商用部署的条件。

中美贸易争端波澜再起。继2016-2018中兴通讯被美国商务部两次制裁之后，华为被列入实体清单，未来中美贸易争端可能边际效用降低，长期科技竞争将代替贸易争端。目前国内产业链核心技术薄弱，向上游核心技术产业升级迫在眉睫，看好未来长期中国信息产业升级及进口替代。

（内容来自网络收集整理）



## SEMI中国区总裁，全球副总裁居龙回顾追踪中美贸易摩擦事件

自1987年来，中国人均收入增长了20倍（根据世界银行数据），美国的贸易逆差一半来自对华贸易，并仍在迅速扩大，中国成为世界工厂。2017年全球半导体市场达到4204亿美元（Gartner），2017年集成电路进口达到2586亿美元，较2016年提高13.6%，远高于同期原油进口。但中国厂商产值不到200亿美元，全球及中国厂商得到商机。

根据主要的IC应用端数据来看：

IDC：智能手机全球出货14.72亿台，中国4.4亿台，约占全球30%；

Gartner：全球PC出货1.6亿台，中国0.54亿台，约占全国20%；

JATO：全球汽车上牌9600万台，中国2580万台，约占全球30%。

中美贸易摩擦事件追踪：

2017.8

特朗普签发备忘录，指示USTR依据《1974年贸易法》第302节就中国展开调查。

USTR发布公告，正式发起调查。

2018.3.22

USTR公布215页的301调查报告。

特朗普随即签署备忘录，只是行政当局采取行动。

2018.4.2-3

中国商务部发布针对232的反制清单。

特朗普政府发布建议征税清单，拟对中国1333种商品加征25%的关税。

2018.4.16

中兴事件

2018.6

美国声明对华500亿美元加征关税；中国发布500亿美元反制征税清单。

特朗普指示美国贸易代表2000亿美元商品清单。

2018.7.6

清单1正式生效及公布清单1产品排除程序。

第一笔340亿美元产品开始征税，中国反制征税同时生效。

2018.7.10

USTR发布建议征税2000亿清单（清单3）。

8月1日USTR声明可能将税率从10%提高到25%。

2018.8.3

中国商务部公告对美国出口600亿产品征收5%-25%的不等关税。

2018.8.23

清单2生效，美对华第二批160亿美元产品开始征税。

2018.9.24

美对华2000亿产品加征10%关税，并将在2019年上半年调关税至25%。

中国对美国600亿美元产品加征关税。

2018.10.29

晋华事件

2018.12.1

中美同意不再加征新关税。

2019.2.25

美国将延迟原定3月1日对中国产品加征关税的措施。

2019.5.9

USTR发布声明宣布，美方将于5月10日将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。

2019.5.13

中国宣布将自6月1日起对价值约600亿美元的美国商品提高关税。



2019.5.15

美国商务部工业和安全局声明，把华为及70个附属公司列入出口管制的实体清单。

美方管制制的14个领域：

2018年11月19日，美国商务部工业与安全局

Department of Commerce · Bureau of Industry and

Security · BIS) 提出了一份针对关键技术和相关产品的出

口管制框架方案，并将面向公众进行为期一个月的意见征询。

涉及管制的14个领域分别是：生物技术、人工智能和机器学习技术、位置、导航和定位技术、微处理技术、先进的计算技术、数据分析技术、量子信息和传感技术、物流技术、增材制造、机器人、脑机接口、高超音速空气动力学、先进技术、先进的监控技术。

美方301报告：

2018年3月22日-11月22日，USTR发布了针对中国与技术转让、知识产权保护和发展创新有关的行为、政策、做法调查结果报告（简称301报告）。

不公平的技术转让：指责中国政府利用所有权利限制、行政事件，审批程序强迫美国公司向中国企业转让技术。

歧视性的法律法规：批判中国关于技术转让的所有权和赔偿责任的相关规定对外资设置歧视性限制。

国家主导对外投资：批判中国政府通过资金支持等手段引导中资企业进行海外并购，并通过高科技领域的并购获取先进技术。

盗取商业机密：指责中国未经授权入侵美国计算机系统，盗取商业机密，对美国公司的全球竞争力构成伤害。

其他可能相关内容：列举了其他可能和301调查相关的内容，但尚不能确定这些法律和政策是否符合纳入301调查的标准。

（根据2019世界半导体大会内容整理）

## 工信部副部长王志军：中国芯片产业取得突破

近日，美方启动对约2000亿美元中国输美商品加征25%关税，并以“国家安全”为幌子，突然发布针对中国华为等公司的限制交易令，这一系列行为让全球哗然。

美方对我国企业和产业的“围堵”“封锁”是否会有“奏效”？如何看待新一轮加征关税对我国制造业的影响？工信部副部长王志军近日接受了新闻媒体联合采访。

### 加征关税对我国制造业影响总体可控

记者：美方新一轮加征关税会对我国制造业产生何种影响？

王志军：据统计，对美的2000亿美元出口商品占2018年我对美出口额的41.8%，但只占我对外总出口额的8%。在一定程度上，加征关税会导致企业运营成本增加，竞争力下降和订单减少，但目前影响总体上是可控的。

也应看到，在受到约2000亿美元加征关税影响的企业中，外资企业数量约占50%，其中很多外资企业是美国企业，这些美国企业的产品大部分的市场是美国。可以说，美国加征关税行为，影响的不仅是中国企业和消费者的利益，也伤害美国企业和消费者的利益，更危及全球产业链和供应链的安全。

记者：美方称，对中国国家加征关税将导致一些企业从中国搬迁到其他亚洲国家，一些美国企业也将迁回美国。请问您怎么看？中国如何应对加征关税对产业链带来的负面影响？

王志军：当前，确实有一些企业从中国搬迁或转移到其他地区，有的是因劳动力成本上升等做出的选择，有的则是出于企业全球经营布局的考虑。我们一直尊重企业的自主选择，鼓励企业根据自身情况做出决策。

应当看到，中国已形成较为完备的基础设施、配套产业体系。营商环境不断优化，新技术新业务应用活跃，消费市场正在升级，前景广阔，依然是全球最具吸引力的投资目的地。

今年1至4月，我国制造业实际利用外资同比增长11.4%，包括特斯拉、巴斯夫在内的一些企业正加大对我国的投资力度。这充分显示了外国投资者对我国经济的坚

定信心。我国一如既往欢迎外国企业来华投资，我们也将继续为外国投资者提供更加稳定、公平、透明、可预期的投资环境。

下一步，我们将进一步实行好“六稳”政策，帮助企业解决短期面临的困难，进一步推动制造业全方位高水平对外开放，继续深化“放管服”改革，着力优化营商环境，进一步推动产业转型升级，加大传统产业技术改造力度，大力培育和壮大新兴产业，推动经济高质量发展。

### 芯片产业取得突破将支持机遇共享开放合作

记者：我国芯片产业发展如何？美相关举措对我芯片和下游应用产业将有哪些影响？

王志军：自2012年以来，我国集成电路产业以年均20%以上的速度快速增长，2018年全行业销售额6532亿美元，技术水平也不断提高。

当前，我国芯片设计水平提升3代以上，海思麒麟980手机芯片采用了全球最先进的7纳米工艺，制造工艺提升了1.5代，32纳米工艺实现规模量产，16/14纳米工艺进入客户导入阶段，存储芯片产业进行了初步布局，64层3D NAND闪存芯片预计今年下半年实现小规模试产，在封装业中占比达到约30%，蚀刻机等高端装备和靶材等关键材料取得突破。当然，与国际先进水平相比，我国集成电路的总体设计、制造、检测及相关设备、原材料生产还有相当的差距。

集成电路产业是高度国际化的产业，没有哪个国家能够独立发展集成电路产业。近期美国一系列举措，粗暴干涉国际集成电路产业正常秩序，打乱了正常的国际分工体系，降低了资源配置效率和产业发展速度，破坏了世界集成电路产业平稳发展。这些举措是对标榜为市场经济体制的极大讽刺。我们再次敦促美方，停止以安全风险为由

对中国企业进行的无理打压，还中国企业在世界包括美国在内开展正常的投资、经营等活动公平、公正的环境。

下一步，我国将更大范围更深层次地融入全球集成电路产业生态体系。坚持开放创新发展，推进产业链各环节开放创新发展，坚持优化营商环境、机遇共享，对内对外一贯原则，加强知识产权保护，与全球集成电路产业界共同分享中国市场带来的发展机遇。

### 我国工业稳中向好中高端增长较快

记者：当前，我国工业运行态势如何，呈现哪些特点？王志军：随着中央部署的适时适度逆周期调节和“六稳”措施的效果显现，货币信贷、社会融资规模保持合理增长，减税降费政策落地实施，极大增强了企业的信心，工业经济运行保持了总体平稳、稳中有进的态势，主要指标保持在合理区间，市场预期明显提升，实现了平稳开局。

从增速看，工业生产总体平稳。尽管4月规模以上工业增加值同比增长5.4%，3月相比回落明显，主要原因是4月制造业增加值权重下降，一些企业为充分享受减税政策，在3月提前备货，增加生产，从前4个月情况看，规模以上工业增加值增速高于全年工业增长预期目标。

从结构看，中高端制造业增长加快。4月高技术制造业增长11.2%，高技术制造业投资增长11.4%，具有较高技术含量和较高附加值的工业新产品产量保持快速增长，3D打印设备、移动通信基站设备等产品产量增速均在30%以上。

从地区看，中部地区保持较快增长。4月份中部地区工业增加值同比增长7%，比去年同期加快2.2个百分点，高于整体工业2.3个百分点。其中，湖北、江西、湖南工业增加值增速分别达8.6%、9.5%和8.5%。

从结构看，企业发展信心持续改善，全面实施小微企业普惠性税收减免，大幅放宽小微企业所得税优惠标准并提高增值税起征点，清理拖欠民营企业中小企业账款，政策红利逐步释放。4月PMI已连续2个月处于景气扩张区间，企业对未来市场预期总体乐观。

下一步，我们将坚定不移推进供给侧结构性改革，推动落实好减税降费举措，优化供给结构引导释放内需增长潜力，加快培育壮大新动能和优质企业，实现工业经济平稳运行和制造业高质量发展。

### 将坚定不移扩大制造业开放加强核心技术攻关

记者：在工业领域，我国会有哪些继续扩大开放的举措？

王志军：按照党中央决策部署，制造业开放步伐不断加快。2018年修订出台的外商投资准入两个负面清单中，开放了飞机、船舶重大装备，明确了汽车开放时间表，取消了稀土等矿产资源冶炼环节对外的限制，一般制造业已全部开放。

下一步，我们将持续推进和提升工业领域对外开放水平。一是全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实飞机、船舶、汽车、电信等领域开放的开放政策。二是推动修订全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，进一步缩减负面清单条目。三是扩大鼓励外商投资的领域和范围，推动重大外资项目加快落地实施。四是坚持内外资企业“一视同仁”原则，深化“放管服”改革，全面清理取消负面清单以外领域对外的准入限制，构建“内外一致”、公平竞争的市场环境。

记者：工信部将出台哪些具体举措加快制造业核心技术攻关？

王志军：此次中美经贸摩擦使我们更清醒认识到，必须持之以恒解决我国关键核心技术“卡脖子”问题。工信部将加强与有关部门的政策协同，积极发挥企业的主体作用，大力推进关键领域核心技术攻关。

一是坚持市场机制与政府作用相结合，发挥市场对技术创新方向、路线选择及各类创新要素配置的的决定性作用，同时引导创新要素更多投向核心技术攻关，加快培育一批竞争力强的领军企业和“专精特新”的中小企业，大力营造公平竞争的市场环境。

二是坚持产学研用紧密结合，构建全产业链协同创新的生态体系，把提升原始创新能力摆在更加突出位置，加大中央财政对基础研究的稳定支持力度，组建产学研用联合体，推动体制机制创新，开展核心技术攻关。

三是坚持深化开放合作与立足自力更生相结合，更好利用国际国内两种资源和提升科技自立能力，我们将不断拓展互惠合作的范围、层次和方式，更高层次地融入全球产业链、创新链，同时做好自力更生、自主研发，努力推动解决制约我国产业发展的重大技术问题。新华社

来源：工信部

## 第二季全球前十晶圆代工营收排名

据拓尔产业研究院最新报告统计，由于全球宏观经济波动，2019年第二季全球晶圆代工需求持续疲弱，各厂营收较去年同期普遍下滑。预估第二季全球晶圆代工总产值较2018年同期下滑约9%，达154亿美元。市占率排名前三分别为台积电、三星与格芯。

| Ranking | Company | 2019 Q2 | 2018 Q2 | QoQ  | YoY    |
|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 1       | 台积电     | 3,751   | 3,735   | +0%  | +0.2%  |
| 2       | 三星      | 2,773   | 3,051   | -9%  | -18.3% |
| 3       | 格芯      | 1,330   | 1,521   | -12% | -8.7%  |
| 4       | 中芯      | 1,050   | 1,252   | -16% | -7.3%  |
| 5       | 华虹      | 790     | 871     | -10% | -5.1%  |
| 6       | 南亚      | 720     | 737     | -2%  | -2.0%  |
| 7       | 联芯      | 715     | 765     | -6%  | -3.1%  |
| 8       | 世界先进    | 214     | 221     | -3%  | -3.0%  |
| 9       | 力晶      | 194     | 207     | -6%  | -2.4%  |
| 10      | 晶合集成    | 144     | 131     | +9%  | +9.2%  |
| Others  |         | 665     | 808     | -18% | -4.4%  |
| Total   |         | 15,363  | 16,748  | -8%  | -10.0% |

2019年第二季晶圆代工企业排名前五与去年相同，第六名至第十名则有变动：力晶因存储器和显示驱动芯片代工需求下滑，排名与去年同期相比由第七名下降至第九名；显示驱动芯片转移至12寸生产的趋势愈加明显，使得不具有12寸产能的世界先进营收受冲击，排名被华虹半导体超越，滑落至第八名。

前十大晶圆代工企业中，仅有华虹半导体受惠于Smart Card、IoT、Automotive的MCU和功率器件等市场需求较为稳定，而与营收较去年同期持平，其余企业皆因市场需求不济、库存尚待消化等原因，

大半导体产业网

第二季营收表现较去年同期下滑约9%。

其中值得关注的是市占率近半的台积电，受惠于7nm为主的先进制程客户需求拉升，其第二季的营收增幅相对于其他业者来的较小，然而受华为事件影响，台积电7nm很难维持其在旗舰手机处理器市场的市占率，这又将进一步影响全球晶圆代工产业2019下半年的表现。三星则凭借完整的产业链和全球渠道布局，将是华为事件潜在的最大受益者。

展望2019年，全球宏观经济的不确定性变动都将为经济带来重大的冲击，使得行业近期已将全球GDP由1月预估的2.9%修正至2.6%，IMF则由原预估的3.6%下调至3.1%。拓尔产业研究院预估，2019年全球晶圆代工产业将出现十年来首次的负成长，总产值较2018年衰退近3%。

来源：拓尔产业研究院

## 1-5月我国集成电路出口增长25.1%

6月13日，商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰向记者回答我国1-5月进出口情况。

今年以来，面对复杂的外部环境，各地区各部门全力营造法治化、国际化、便利化的营商环境，广大外贸企业迎难而上，创新发展，我国外贸进出口保持稳中有进的发展势头。根据海关统计，1-5月我国进出口12.1万亿元，同比增长4.1%。其中，出口6.5万亿元，增长6.1%；进口5.6万亿元，增长1.8%；顺差6933.6亿元，扩大45%。

一是国际市场布局更加多元。与“一带一路”沿线国家贸易规模进一步扩大。进出口增长9%，占比提高至28.8%。与欧盟、东盟、俄罗斯和巴西等进出口分别增长11.7%、9.4%、10.0%和11.2%。同期，对美国的进出口下降9.6%。

二是民营企业出口占比超过50%。民营企业出口3.28万亿元，增长13.8%，占比提高3.2个百分点至50.4%。外商投资企业出口2.56万亿元，增长0.5%。国有企业出口6375.1亿元，下降5.9%。

三是商品结构持续优化。机电产品出口3.8万亿元，增长5.1%，占出口总值的58.4%。其中，集成电路、电动机及发电机等产品出口分别增长25.1%、7.6%。七大类劳动密集型产品保持竞争优势。出口1.21万亿元，增长7.2%。其中，玩具、塑料制品、家具分别增长30.1%、18.6%和09.6%。

四是一般贸易出口较快增长。一般贸易出口3.82万亿元，增长10.3%，占比提高2.1个百分点至58.8%。加工贸易出口1.92万亿元，下降1.5%。

五是国内区域布局更加均衡。中部和西部地区出口增长14.7%，占比提高1.3个百分点至17.6%。东部地区出口增长4.4%，占比82.4%。

来源：商务部网站

## 全球FAB设备支出2020年开始以20%的速度增长

美国加州时间2019年6月11日，根据国际半导体行业协会SEM发布的2019年第二季度世界晶圆厂预测更新，全球晶圆厂设备支出在2019年下降19%至484亿美元后，将在2020年反弹，增长20%至584亿美元。

2020年投资增幅虽从今年早些时候的27%增长预期下调，2019年支出下降19%，较之前预计的下降14%更多。尽管预测2020年将健康增长，但Fab支出仍将比2018年的投资减少20亿美元。

仅Memory领域支出预计在2019年的衰退中占较大比例，下降45%，应该在2020年实现45%的强劲复苏，达到280亿美元。2020年Memory投资的增长将同比增长超过80亿美元，推动Fab支出整体扩张。然而与2017年和2018年的支出水平相比，2020年的Memory投资仍将大大减少。

在今年Memory支出下降的两个反向趋势中，预计Foundry的投资将增加29%，微处理器增长超过40%，这得益于10nm MPU的推出。值得注意的是，整个微处理器支出与代工和内存投资相比相形见绌。

全球Fab厂预测更新(The World Fab Forecast update)跟踪了2018年至2020年的440个Fab厂和产线的投资项目。SEMI半年的数据回顾(图1)显示，2019年上半年Memory支出将下降48%，3D NAND和DRAM投资分别下降60%和40%。



Figure 1: Fab equipment spending by half year from 2018 to 2020

尽管一个细分领域出现了大幅下降，但2019年上半年的总体支出将被领先代工厂的投资增长40%部分抵消。由于MPU是其关键驱动因素，预计上半年微处理器支出将增长16%，下半年将再增长9%。

来源：SEMI/中国



## IC Insights评出十大模拟IC厂，业绩普遍增长

Leading Analog IC Suppliers (\$M)

| 2018 Rank | Company            | 2017  | 2018   | % Change | % Marketshare |
|-----------|--------------------|-------|--------|----------|---------------|
| 1         | Texas Instruments  | 9,300 | 10,821 | 16%      | 18%           |
| 2         | Analog Devices     | 5,519 | 5,595  | 1%       | 9%            |
| 3         | Infineon           | 3,951 | 3,810  | -4%      | 6%            |
| 4         | Stmicroelectronics | 3,710 | 3,686  | -1%      | 6%            |
| 5         | ST                 | 2,591 | 2,398  | -8%      | 5%            |
| 6         | ADI                | 2,413 | 2,440  | 1%       | 4%            |
| 7         | Maxim              | 2,203 | 2,125  | -4%      | 4%            |
| 8         | ON Semi            | 1,800 | 1,990  | 11%      | 3%            |
| 9         | Microchip          | 1,140 | 1,289  | 13%      | 2%            |
| 10        | Renesas            | 815   | 800    | -2%      | 2%            |

\*Figures include sales from acquired companies in 2017 and 2018.  
Source: IC Insights, company reports.

近日，据IC Insights最新报告显示，德州仪器2018年来自模拟产品的销售额增至108亿美元，继续扩大其作为全球顶级模拟IC供应商的领导地位。

报告显示，英飞凌排在全球模拟产品销售的第三位，ST的年度增长最多，达到了26%。前十大模拟IC供应商的销售额共占模拟IC市场总量的60%，共计361亿美元，2017年时为330亿美元，占总量的61%。

IC Insights的报告中对前50大半导体供应商进行了排名，并列出了几个主要产品类别的领先公司，包括DRAM、闪存、微处理器、微控制器和模拟IC。下图显示了2018年最大的10家模拟供应商。

凭借模拟销售额108亿美元和18%的市场份额，德州仪器继续保持领先地位。IC Insights指出，2018年的模拟销售额增长了9亿美元，几乎是排名第二的ADI公司的两倍，超过排名第10的瑞萨电子是前十名中仅有的两家销售额下降的公司之一。德州仪器2018年的模拟收入占IC销售额139亿美元的78%，占其半导体总收入149亿美元的72%。

德州仪器的主要目标是工业应用（占2018年营收的36%），个人电子（占2018年营收的25%）和汽车应用（占其模拟产品营收的20%）。德州仪器表示，这三个领域的利润率都很高，为其提供了未来增长的最佳机会。值得注意的是，工业和汽车应用占据了德州仪器去年总收入的56%，而在5年前，这一比例仅为42%。

排在第二的ADI去年模拟IC销售额增长了7%，达到55亿美元。ADI的收入数据包括Linear Technology的并购

额。ADI于2017年第一季度以158亿美元的股权和股票收购了这家公司。2018年，在ADI的客户中没有一家的销售额能够占ADI销售额的10%以上。而在此之前，ADI最大的客户苹果，分别占据了其2017年和2016年总收入的14%和12%。

欧洲三大IC供应商中的每一家在2018年都是前十大模拟供应商。这三家公司共占全球模拟市场份额的15%。英飞凌上升一位至第三，其模拟销售额增长14%至38亿美元，占市场份额的6%。英飞凌继续扩大了其在汽车（2018年销售额的43%）和电力管理（2018年销售额的31%）应用方面的业务，而工业电源控制（17%）和芯片卡和安全性（9%）则完善了英飞凌其他主要的终端应用。

ST的模拟产品销售额增长了26%，达到32亿美元（5%的市场份额），在十大模拟产品供应商中增长最多。ST的大部分模拟IC销售目标是运动控制（电机驱动IC和高压驱动IC）、自动化（智能电源开关）和能源管理（电力线通信IC）应用。

恩智浦是2018年第六大模拟供应商，销售额增长10%，达到26亿美元（市场份额为4%）。恩智浦将其模拟器件用于许多系统功能中，但其主要增长领域之一是汽车，其模拟芯片是新兴的LIDAR、车联网和5G系统中必不可少的组件。

安森美半导体的模拟销售额增长了11%，达到20亿美元，占市场份额的3%。安森美的销售额增长率为11%，此前2017年和2016年分别为35%和16%。安森美连续三年实现强劲模拟销售增长。部分原因是该公司于2016年9月收购了仙童半导体。另外，安森美正在汽车市场上销售了大量电源管理产品，特别是用于主动安全、助力总成、车身电子和照明应用的产品。

Microchip Technology的模拟IC销售额在2018年增长了22%。2018年5月，Microchip以83.5亿美元收购了Microsemi，从而推动了Microchip在计算和通信应用领域的模拟业务。

来源与中网

## 紫光国微拟180亿元收购Linxens，转让紫光国芯股权发生变动

【数日前，紫光国微对外宣布，公司向西藏紫光神彩投资有限公司、西藏紫钰海润科技发展有限公司、西藏紫钰海联电子科技有限公司、红帆资本投资管理咨询有限公司和宁波海山保税港区鑫峰股权投资管理有限公司购买其合计持有的北京紫光联盛科技有限公司（以下简称“紫光联盛”）100%的股权。】

本次交易完成后，紫光联盛将纳入上市公司合并报表范围。据悉，紫光联盛为持股型公司，为收购Linxens相关资产于2018年出资设立，Linxens在法国、德国、新加坡、泰国、中国等国家设有运营实体。Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID载体及天线和超薄柔性LED灯带，是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产商之一。

6月2日，紫光国微披露，本次收购标的资产的价格初步约定为180亿元，及标的资产的审计和评估工作尚未完成，整个收购案尚在推进中。据申请，紫光国微股票将于6月3日开市复牌。

### 180亿收购案

方案显示，紫光国微拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫钰海润、紫光海联、红帆资本和鑫峰投资购买其合计持有的紫光联盛100%股权。交易完成后，紫光联盛将纳入上市公司合并报表范围。

其中，持有紫光联盛75%股权的紫光神彩，和上市公司紫光国微同属紫光集团控制下的企业，分别持股紫光联盛8.33%股权的股东紫钰海润和紫钰海联都是紫光集团关联人赵旭国控制的企业；持股2.78%的鑫峰投资是紫光集团间接参股的企业。

方案显示，交易价格和初步定为180亿元。但截至目前，紫光联盛会计实收资本也为180亿元。据媒体报道，2018年7月，紫光集团通过紫光联盛收购Linxens时，总交易金额约为22亿欧元（26亿美元）。

### 市盈率低至8倍

尽管紫光国微表示的公司紫光联盛尽职调查和审计工作量大，且成用的国际财务报告准则与国内公司适用的企业会计准则有所差异，并没有披露本次公司的财务数据。但在早前，紫光国微披露的《日常关联交易公告》中，曾发布过Linxens 2017年经审计的财务数据和2018年未经审计的财务数据。

2017年度，Linxens实现营业收入1.99亿美元，净利润为9759.07万美元（约合人民币6.75亿人民币），净利润

高达49%。

截至2018年9月30日，Linxens未经审计总资产为3.70亿美元，净资产为3.51亿美元；2018年1-9月，Linxens实现营业收入1.47亿美元，净利润为1.00亿美元（约合人民币6.94亿人民币），净利润高达68%。（未经审计）

从Linxens官网了解到，其2018年总营业额约为4.3亿欧元（约为4.81亿美元、33亿元人民币），如果按照2017年和2018年1-9月的净利润率计算，其2018年全年的净利润约在16亿人民币-22亿人民币之间。

如果按照2017年的净利润率测算，此次180亿元的收购价对应的收购市盈率为26.7倍，而如果按照测算的2018年净利润测算，此次收购的市盈率则约为18倍-11.25倍。wind数据显示，申万三级行业——集成电路行业上市公司的平均市盈率高达81.35倍，截至最新收盘价，紫光国微的动态市盈率也高达74.5倍。相比之下，Linxens的收购价格确实不算高。

### 此外关注

去年下半年，紫光国微将西安紫光国芯半导体有限公司（以下简称“西安紫光国芯”）100%股权转让给控股股东紫光集团下属全资子公司北京紫光存储技术有限公司（以下简称“紫光存储”），经交易双方协商确定为22,000万元。本次转让完成后，紫光国微将不再持有西安紫光国芯股权。

紫光国微公告披露，为便于后续与西安紫光国芯的业务合作，拟对上述股权转让方案进行调整，将原转让西安紫光国芯100%股权调整为转让其76%股权给紫光存储。

本次交易价格以西安紫光国芯股权评估结果为依据，经交易双方协商确定为16,777.76万元。本次股权转让完成后，公司仍持有西安紫光国芯24%股权，将其不再纳入公司合并报表范围。交易对方紫光存储为公司间接控股股东紫光集团的全资子公司，为公司的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

紫光国微表示，本次股权转让可以减轻上市公司的资金压力，改善财务状况和盈利能力，同时有利于西安紫光国芯的后续发展。股权转让完成后，公司将持有西安紫光国芯24%的股权，不再将其纳入合并报表范围。公司将专注于安全芯片设计领域，致力于成为“安全芯片领导者”，符合公司发展战略。

来源 登载稿



## X-FAB 特色制程工艺分享会2019

X-FAB 是世界最大的模拟/混合信号集成电路晶圆代工厂企业，是针对汽车电子，医疗，工业控制，传感器，混合信号等领域IC设计的纯代工单位。想知道我们在精密模拟/混合信号领域的专长以及提供哪些针对性设计服务来支持您的集成电路制造吗？

我们诚心邀请您参加来我们的中国分享会。德国品质，值得信赖！

The poster features the X-FAB logo and the text 'MIXED-SIGNAL FOUNDRY EXPERTS' and '特色制程工艺分享会2019'. It highlights various capabilities: 'Accurate Modeling', 'PDK with Proven ESD', 'High Temperature', 'Automotive Certified', 'Robust Processes', 'Sensors', 'High Voltage', 'Medical', and 'Industrial'. The bottom section lists three roadshow events: '北京 (7月8日)', '西安 (7月10日)', and '成都 (7月12日)'. The background is a globe with puzzle pieces.

西安，7月10日

西安中兴和泰酒店，曲江厅

雁塔区 唐延南路10号

### 议程大纲

- 1:15pm~1:45pm 登记
- 1:45pm~2:15pm X-FAB公司简介
- 2:15pm~3:00pm X-FAB 完善、明确的设计支持服务
- 3:00pm~3:30pm X-FAB 的特色模拟工艺（高压，高温，低噪音）
- 3:30pm~4:00pm 茶歇
- 4:00pm~5:00pm X-FAB 在电磁波不同频段的应用和解决方案（RF SOI, 光学, X射线）
- 5:00pm~5:10pm 国家集成电子设计产业化基地介绍
- 5:10pm~5:30pm 分享和交流

### 报名登记

免费入座，但座位有限，请感兴趣的朋友提前报名参加！

请提供您的信息（姓名/公司/联系方式）

发送邮件至 [zhangbei@xaic.com.cn](mailto:zhangbei@xaic.com.cn)

或电话报名参加

联系方式：张女士 15091753834